

2022.3.1 ニュースリリース

海外大手半導体パッケージ基板メーカーより 『はんだボールマウンタ』大口受注のお知らせ

AIメカテック株式会社(本社:茨城県龍ケ崎市向陽台、社長:阿部 猪佐雄)は、海外大手半導体パッケージ基板メーカーよりはんだボールマウンタ設備を検査・リペア装置含めたシステム一括ラインとして大口受注致しましたので以下の通りご報告申し上げます。

5G通信、ビッグデータ、IoT及びAIなどを背景にデータセンター、モバイル機器及び車載用途など半導体パッケージの需要は拡大しており、同時に、安定した品質と良品率の更なる向上が求められております。

当社は、コア技術である高精度位置合せ技術と半世紀以上培ってきた印刷技術及びノウハウを盛り込んだ新型機Gシリーズをご提案して参りました。
その結果、高い評価をいただき大口受注に至りました。

FCBGA、MCU/MPU、2.5/3D、ファンアウトなど先進半導体パッケージでは高品質・高良品率へのニーズが高く、歩留り率向上を実現できる当社設備の採用が検討されおります。今後の更なる半導体関連事業拡大へ寄与していくと期待しております。

当社は、今後も製造プロセスのイノベーションを通してより便利で豊かな生活スタイルの向上により社会に貢献できる企業を目指して参ります。

お問い合わせ

AIメカテック株式会社

営業部 TEL:0297-62-9119

<https://www.ai-mech.com/>